O Capítulo 5, intitulado "Redução de Dimensionalidade e Métodos de Variáveis Latentes (Parte 1)", foca em duas técnicas principais de aprendizado de máquina para modelagem e monitoramento de sistemas de processos: Análise de Componentes Principais (PCA) e Mínimos Quadrados Parciais (PLS).

O capítulo começa com uma introdução ao PCA, explicando seu background matemático e ilustrando sua capacidade de redução de dimensionalidade usando dados de um processo de manufatura de polímeros. É demonstrado como o PCA pode capturar a maior parte da informação dos dados em poucas componentes principais, analisando a variância explicada por cada componente. O capítulo também aborda a reconstrução dos dados originais a partir das componentes principais e a quantificação da informação perdida nesse processo.

Em seguida, o capítulo detalha a aplicação do PCA para monitoramento de processos na manufatura de polímeros. São introduzidos dois índices de monitoramento, o índice T² de Hotelling e a estatística SPE (ou Q), utilizados para detectar condições anormais no processo. O cálculo dos limites de controle para esses índices e a importância de monitorar ambos são discutidos. Além da detecção de falhas, o capítulo explica como o PCA pode ser usado para o diagnóstico de falhas, identificando as variáveis de processo que contribuem mais para a condição anormal através de gráficos de contribuição para T² e SPE.

O capítulo também explora variantes do PCA clássico, incluindo PCA Dinâmico, PCA Multiway e PCA com Kernel (KPCA), mencionando suas aplicações e a capacidade do KPCA para lidar com dados não lineares através do mapeamento para um espaço de características de maior dimensão.

A segunda parte do capítulo introduz o PLS, explicando seu background matemático. É apresentada a aplicação do PLS para "soft sensing" (sensoriamento suave ou virtual) em um processo de manufatura de celulose e papel, onde o PLS é usado para predizer a qualidade do produto (número Kappa) com base em outras variáveis de processo medidas. O processo de determinação do número ideal de componentes latentes no PLS é abordado.

Finalmente, o capítulo discute o uso do **PLS para monitoramento de processos** na manufatura de polietileno. São apresentados **índices de detecção de falhas específicos para PLS** (T², SPEx e SPEy) e como eles podem indicar o início de anormalidades no processo, mesmo quando as variáveis de qualidade não mostram sinais claros.

Em resumo, o Capítulo 5 fornece uma introdução detalhada e aplicações práticas de PCA e PLS para redução de dimensionalidade, monitoramento de processos (detecção e diagnóstico de falhas) e sensoriamento suave em sistemas de processos.